

Willkommen bei O-Leading

Wir sind professioneller Leiterplattenhersteller mit mehr als zehn Jahren Erfahrung. Einzelne Produktreihe, doppelseitige, mehrschichtige Leiterplatte, flexible Leiterplatte und MCPCB. Wir bieten schnellen Prototypservice - S / S in 24 Stunden, 4-8 Schichten in 48-96 Stunden Produktionszeit.

KUPFERPLATTENLÖCHER MINDEST .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER DÜRFEN NICHT GESTROMT WERDEN

Packen Sie mit farbloser, transparenter Luftpolsterfolie, 25 Stck./Tasche, Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite

BITTE KLICKEN SIE DIESE FÜR WEITERE INFORMATIONEN: [Motor Power Module Hersteller China](#)

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Schnelle Details

10 stück

Herkunftsort	Guangdong China (Festland)	Markenname	O-Leading
Basismaterial	FR-4, Aluminium	Brettstärke	0,1-5 mm
Oberflächenveredelung	Immersionsgold, OSP, bleifreies HASL	Mindest. Lochgröße	0,2 mm
anwendbar auf	LED, Handy, Klimaanlage, Waschmaschinen	Mindest. Linienbreite	0,2 mm
Zertifikate	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Mindest. Zeilenabstand	0,2 mm
Charakter	Industrielle Steuerungsplatine	Preis	\$ 0,1- \$ 10
Modell-Nr	pcba-hersteller von energienbanken	Größe	0,01m3-10m3
Design-Typ	Kundenanforderung	Q / CTN	10PCS-100PCS
Gewicht	0,01 kg bis 5 kg	Brettstärke	0,1-5 mm
MOQ	Kupferdicke	0,5 oz-5 oz	

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen:	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferung Detail:	7-12days

Produktbeschreibung

16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenfertigung

Artikel	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Probe	Volumen	Probe	Volumen	Probe
Schichtanzahl	32	42	38	44	42	48
Min Line / Abstand (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min Bohrloch Durchmesser (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Seitenverhältnis von PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Beliebige Schichtverbindung	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plattenfüllung über	JA	-	JA	-	JA	-
Mindest. Kernstärke (ohne Kupfer) (µm)	50	40	40	30	40	30
Mindest. Laser Bohrer Durchmesser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via auf begraben Loch / gestapelt via	JA	-	JA	-	JA	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, schweres Kupfer usw.					
Embedded-Kondensator-PCB	JA	-	JA	-	JA	-
Oberflächenprozess	Bleifreies HASL, ENIG, OSP, Immersionssilber, Immersionsdose, Flash-Gold, Vergoldung mit Finger, Selektive Hartvergoldung, Abziehbare Lötmaske, Carbon-Tinte					



www.o-leading.com

[Aluminium Basisplatine Hersteller China, LED-Leiterplatte Platine in China](#)

Unser Team





Zertifizierungen



2017/26 2016VZL430354 - Wiring, Printed - Component

ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [iQ™ Family of Databases](#).
Click on a product designation for complete information.

[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

E490354

	Cond Width				Max				Max			
	Min	Min	Cond		SS/	Area	Solder		Oper	Flame	Heat	
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Limits	Temp				UL796	
Type	mm(In)	mm(In)	mic(mil)	DSO	mm(In)	C	sec	C	Class	DSR	I	
HullBayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	230	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.7 (0.4)	260	10	170	V-0	AB	-	
HullBayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	AB	-	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	AB	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	AB	-	
O-LEADING-205												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Making: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test designation.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

https://www.ul.com/Products/PrintedWiringBoards/PrintedWiringBoards/ZPMV2.E490354/Wiring,Printed-Component/26172



Test Report

No. CANEC1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Trisbromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Trisbromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is a global leader in testing, inspection and certification services. We are committed to providing our clients with the highest quality of service and the most reliable results. Our services are recognized by the international community and are a key factor in the success of many of the world's leading companies. For more information, please visit our website at www.sgs.com.

Verpackung & Lieferung

Verpackungsinformationen	16 Jahre professioneller OEM Leiterplattenhersteller
Lieferungsdetails	7-12days

☐ GOLDENER FINGERPLATTE Lieferant ☐



FAQ

1. Wie sichert O-Leading Qualität?

Unser hoher Qualitätsstandard wird mit folgendem erreicht.

1. Der Prozess wird streng nach ISO 9001: 2008 Standards kontrolliert.
2. Umfassender Einsatz von Software zur Verwaltung des Produktionsprozesses
3. Stand der Technik Testgeräte und Werkzeuge. Z.B. Flying Probe, Röntgeninspektion, AOI (Automated Optical Inspector) und ICT (In-Circuit-Test).
4. engagiertes qualitätssicherungsteam mit fehlerfallanalyseprozess
5. Kontinuierliche Schulung und Schulung des Personals

2. Wie hält O-Leading Ihren Preis wettbewerbsfähig?

Im letzten Jahrzehnt hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht. Chinesische Währung RMB hatte 31% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet; Und unsere Arbeitskosten sind auch deutlich gestiegen. O-Leading hat jedoch unsere Preise stabil gehalten. Dies trägt ganz zu unseren Innovationen bei der Kostenreduzierung, der Vermeidung von Verschwendung und der Verbesserung der Effizienz bei. Unsere Preise sind in der Branche auf dem gleichen Qualitätsniveau sehr wettbewerbsfähig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft ist für beide

Seiten von Vorteil, wenn wir Ihnen einen Kosten- und Qualitätsvorteil bieten können.

3. Welche Arten von Boards können von O-Leading verarbeitet werden?

Gängige FR4-, High-TG- und halogenfreie Platinen, Rogers, Arlon, Telfon, Platinen auf Aluminium- / Kupferbasis, PI usw.

4. Welche Daten werden für die Leiterplattenproduktion benötigt?

Es ist am besten, Daten im Gerber 274-X-Format bereitzustellen. Darüber hinaus können Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP und Eagle verarbeitet werden.

5. Was ist der typische Prozessablauf für mehrschichtige Leiterplatten?

Materialschneiden → Innerer Trockenfilm → Inneres Ätzen → Inneres AOI → Multi-Bond → Schichtstapel Pressen → Bohren → PTH → Plattieren → Äußerer Trockenfilm → Musterplattieren → Äußeres Ätzen → Äußeres AOI → Lötmaske → Bauteilmarkierung → Oberflächenfinish → Routing → E / T → Sichtprüfung.